

# 2007—2008年中国芯片设计行业发展趋势决策咨询及行业竞争力分析研究报告

报告大纲

观研报告网

[www.chinabaogao.com](http://www.chinabaogao.com)

## 一、报告简介

观研报告网发布的《2007—2008年中国芯片设计行业发展趋势决策咨询及行业竞争力分析研究报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/yuanqijian/2802528025.html>

报告价格：电子版: 11000元 纸介版：12000元 电子和纸介版: 13000

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、报告目录及图表目录

【交付时间】	2-3个工作日	【报告格式】	Word格式	研究报告目录	第一章																														
我国芯片设计行业发展环境分析	第一节	2007年前三季度中国宏观经济形势分析	一、工业生产继续快速增长，企业利润大幅度增加	二、固定资产投资增长较快	三、信贷增速仍然较快	四、流动性过剩较突出	五、国内市场销售快速增长，居民消费价格继续上涨	第二节																											
行业政策变化及影响	第三节	相关行业发展分析	一、通信行业发展及其影响	二、汽车行业发展及其影响	三、电子消费类行业发展及其影响	四、其他相关行业发展及其影响	第二章																												
全球芯片设计行业发展分析	第一节	2007年全球经济发展	一、世界经济在上升通道中收紧流动性	二、美元持续走低	三、考验世界经济弹性	第二节	全球芯片设计业竞争格局	第三节																											
主要国家和地区芯片设计行业发展情况	一、美国	二、欧洲	三、日本	四、韩国	五、台湾	第四节																													
全球芯片技术发展趋势	一、小型化、高灵敏度	二、多功能	三、芯片节能日益受到关注	第三章																															
中国芯片设计行业发展分析	第一节	中国芯片设计业发展历程	第二节																																
2007年芯片设计业发展现状及特点	第三节	中国芯片设计业竞争格局	第四节																																
中国芯片设计业存在的主要问题	一、企业规模过小	二、产业链不完整	三、资金实力相对薄弱	四、人才缺乏	第四章																														
中国芯片行业供需分析	第一节	中国芯片消费市场分析	一、中国芯片消费市场规模	二、主要行业对芯片的需求分析	1、通信	2、汽车	3、电视	4、手机	第二节	中国芯片制造市场分析	一、芯片的产量分析	二、芯片的产能分析	三、产品的生产结构分析	第三节																					
中国芯片制造市场竞争格局	第四节	中国芯片制造业存在的主要问题	第五节																																
2008年中国芯片市场供需预测	第五章	芯片行业细分市场	第一节																																
电子芯片	一、电子芯片市场规模	1、电源管理芯片	2、LED外延芯片	二、市场内主要竞争者分析	三、电子芯片最新技术发展	四、电子芯片市场发展前景	第二节	通信芯片	一、通信芯片市场规模	二、市场内主要竞争者分析	三、通信芯片最新技术发展	四、下游行业对通信芯片的推动	1、无线数据传输	2、无线Internet	3、无线数据传输	五、通信芯片市场发展前景	第三节	显示芯片	一、显示芯片市场规模	二、市场内主要竞争者分析	三、显示芯片最新技术发展	四、显示芯片市场发展前景	第四节	数字电视芯片	一、数字电视芯片市场规模	二、市场内主要竞争者分析	三、数字电视芯片最新技术发展	四、数字电视芯片市场发展前景	第五节	微芯片	一、微芯片市场规模	二、市场内主要竞争者分析	三、微芯片最新技术发展	四、微芯片市场发展前景	第六章
七大产业基地发展分析	第一节	北京	一、基地在全国芯片设计行业中的地位	二、基地发展规模及特点	三、基地发展优势	四、发展前景分析	第二节	上海	一、基地在全国芯片设计行业中的地位	二、基地发展规模及特点	三、基地发展优势	四、发展前景分析																							

第三节 深圳	一、基地在全国芯片设计行业中的地位二、基地发展规模及特点三、基地发展优势四、发展前景分析
第四节 西安	一、基地在全国芯片设计行业中的地位二、基地发展规模及特点三、基地发展优势四、发展前景分析
第五节 杭州	一、基地在全国芯片设计行业中的地位二、基地发展规模及特点三、基地发展优势四、发展前景分析
第六节 无锡	一、基地在全国芯片设计行业中的地位二、基地发展规模及特点三、基地发展优势四、发展前景分析
第七节 成都	一、基地在全国芯片设计行业中的地位二、基地发展规模及特点三、基地发展优势四、发展前景分析
第七章 国内典型企业分析	第一节 炬力集成电路设计有限公司
一、公司简介二、公司主要产品及经营情况三、最新技术研发情况	四、公司竞争力分析
第二节	中国华大集成电路设计集团有限公司
一、公司简介二、公司主要产品及经营情况三、最新技术研发情况	四、公司竞争力分析
第三节	北京中星微电子有限公司
一、公司简介二、公司主要产品及经营情况三、最新技术研发情况	四、公司竞争力分析
第四节	大唐微电子技术有限公司
一、公司简介二、公司主要产品及经营情况三、最新技术研发情况	四、公司竞争力分析
第五节	深圳海思半导体有限公司
一、公司简介二、公司主要产品及经营情况三、最新技术研发情况	四、公司竞争力分析
第六节	无锡华润矽科微电子有限公司
一、公司简介二、公司主要产品及经营情况三、最新技术研发情况	四、公司竞争力分析
第七节	杭州士兰微电子股份有限公司
一、公司简介二、公司主要产品及经营情况三、最新技术研发情况	四、公司竞争力分析
第八节	上海华虹集成电路有限公司
一、公司简介二、公司主要产品及经营情况三、最新技术研发情况	四、公司竞争力分析
第九节	北京清华同方微电子有限公司
一、公司简介二、公司主要产品及经营情况三、最新技术研发情况	四、公司竞争力分析
第十节	展讯通信(上海)有限公司
一、公司简介二、公司主要产品及经营情况三、最新技术研发情况	四、公司竞争力分析
第八章 国外典型企业分析	第一节 高通 (Qualcomm)
一、公司核心竞争力分析二、中国成为高通第二大市场三、高通最新动态	
1、高通赔偿博通1960万美元	3G手机芯片或停产
2、高通发布新型“全功能集成芯片”系列方案	
3、高通推出面向大众市场的高速数据芯片组	
第二节 博通 (Broadcom)	一、公司核心竞争力分析二、2007,博通公司的“维权年”三、博通和晖悦共推出中国首个数字电视方案四、博通最新动态
1、Broadcom芯片加速下一代“绿色”数据中心建设	
2、Broadcom新款芯片助千兆以太网进入家用市场	3、博通发布高度整合3G单芯片采用HSPA制式
第三节	NVIDIA

一、公司核心竞争力分析二、中国区业务发展情况三、公司最新动态 第四节  
新帝 ( SanDisk ) 一、公司核心竞争力分析 二、中国区业务发展情况 三、公司最新动态  
第五节 AMD 一、公司芯片设计核心竞争力分析二、中国区芯片业务发展情况三、竞争优势  
分析四、公司最新动态第九章 芯片设计行业投资风险分析 第一节  
宏观经济发展与芯片设计行业的相关性分析 第二节 政策风险评价  
一、产业政策风险二、信贷政策风险三、金融政策风险 第三节 行业竞争风险 第四节  
人力资源风险 第五节 行业风险综合评价第十章 芯片设计行业投资建议 第一节  
行业发展前景分析 第二节 行业投资建议

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/yuanqijian/2802528025.html>